

●국토교통부고시 제2024-1053호

건설신기술 지정(2663)

‘탈착클립과 하이브리드 프레임을 이용한 반도체 공장건축물의 외장재 시공기술’을 신기술로 지정하였기에 「건설기술 진흥법 시행령」 제33조 제1항의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2025년 1월 7일

국토교통부장관

1. 신기술개발자

신청인(1)	법인명(성명)	(주)월테크(김두영, 김의원)		
	주 소	우14058 경기도 안양시 동안구 흥안대로 445(K비즈리움 610호)		
	전화번호	031-342-0557	팩스번호	031-342-0582
신청인(2)	법인명(성명)	삼성물산(주)(오세철)		
	주 소	우05288 서울특별시 강동구 상일로6길 26		
	전화번호	02-2146-7906	팩스번호	02-2145-6470
신청인(3)	법인명(성명)	현대알루미늄(주)(박준영)		
	주 소	우33016 충남 논산시 가야곡면 원앙로503번길 117		
	전화번호	02-2103-3141	팩스번호	02-2103-3079

2. 신기술의 개요

- 지정번호 : 제1009호
- 명 칭 : 탈착클립과 하이브리드 프레임을 이용한 반도체 공장건축물의 외장재 시공기술
- 기술분야 : 건축 > 마감 > 금속, 건축 > 특수 건축물 > 복합구조물
- 신기술의 내용

이 신기술은 다수의 개별 메탈패널을 유닛 프레임에 고정하고 배면에 강재 바탕 프레임을 결합한 하이브리드 프레임 구조의 메탈패널 유닛을 공장제작하고 현장에서 구조체에 미리 설치된 앵커브라켓과 결합함으로써 교체가 용이하고 시공성을 향상시킨 반도체 공장건축물의 외장재 시공기술이다.

○ 신기술의 범위

알루미늄재 패널프레임이 부착된 다수의 개별 메탈패널을 탈착클립을 이용해 알루미늄재 유닛 프레임에 고정하고 유닛 프레임 배면에 바탕 프레임을 결합한 메탈패널 유닛을 현장에서 구조체에 미리 설치된 앵커브라켓과 결합하는 반도체 공장건축물의 외장재 시공기술

3. 신기술개발자에 대한 보호내용

- 가. 보호기간 : 고시일로부터 8년
- 나. 보호내용 : 건설기술 진흥법령 참조
 - 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음
 - 발주청에 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음
 - 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을 우선 적용하게 할 수 있음

4. 신기술품셈

- 해당 없음

5. 기 타

- 본 건 신기술의 구체적 내용은 진흥원 홈페이지(<http://www.kaia.re.kr>) 「지식/성과도서관/신기술·추천기술」에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.